

令和元年 5月 7日
一般社団法人 日本電子デバイス産業協会
事務局次長 小林 関 司

材料部品部会主催の第二十三回勉強会のご案内

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

来る6月13日(木曜日)に下記のテーマで材料部品部会主催の第二十三回勉強会を実施いたします。

日本の電子デバイス産業を発展させる為には国内外の動向を常に把握し次世代を見据えた電子デバイスの開発が望まれるところです。今回の勉強会では、三人の講師をお招きし国内外の最新の技術動向、電子デバイス産業の今年の見通しを中心に下記のテーマで勉強会を実施いたします。

今回の勉強会も大変貴重な機会ですので皆様のご参加をお待ちしております。

日時 令和元年6月13日(木) 13:00～16:30
場所 御茶ノ水めっきセンター 4F会議室 03-3814-5621 (代)
東京都文京区湯島1-11-10 <http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

[プログラム]

13:00～13:50

「最新ヘテロジニアス・インテグレーションの動向」

講師 宇都宮 久修 氏/インターコネクション・テクノロジーズ(株)代表

13:50～14:40

「超臨界流体の半導体プロセス応用」

～～薄膜形成を中心として～～

講師 近藤 英一 氏/ 山梨大学・工学部 教授

(14:40～15:00 休憩)

15:00～16:30

「グローバル化の崩壊が始まった！！」

～～カスタマイズ重視のIoTデバイスが一気上昇～～

講師 泉谷 渉 氏/ (株)産業タイムズ社・代表取締役社長

(注) 参加希望の方は別紙回答用紙にて、**6月6日までに**メールでお申し込みください。

確認後メール返信いたします。

募集予定人員60名(定員を超えたら、締め切らせていただきます)。

なお当日、配布資料代としてNEDIA会員の方は2,000円/人を、また非会員の方は5,000円/人(資料代含む)を徴収いたしますのでご承知おきください。

以上